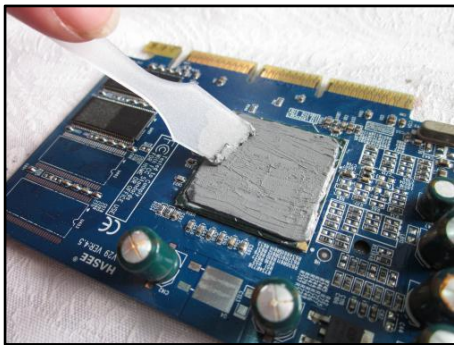


无硅导热膏 Non-silicone Thermal Grease

【产品概述 Product Description】

AG560-20 无硅导热膏是一种导热界面材料的非硅膏状化合物, 不易变干; 它可以把热能从发热设备引导至散热片和底盘上. 该产品在导热金属氧化物被填充的情况下依然能够绝缘导热. AG560-20 有低渗透性, 良好的耐温性和低流动性的特点, 无硅烷小分子挥发, 不会产生碳化硅引起电路不良.

【产品图示 Product illustration】



【典型应用/Applications】

- 高频微处理器、手机
- 笔记本和台式电脑
- 计算机
- 电源适配器
- 音频视频设备
- LED 照明产品

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料. 虽然是以诚信提供, 但由于我们无法控制产品的使用条件和方法, 无法对兼容性的应用提出任何建议, 因此这些建议及数据仅供参考, 而不作为产品保证. 在任何时候, 应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用. 应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途. 不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途. 我们建议潜在用户在大量使用前, 首先确定我们的材料适用性和建议.

特性参数 AG560-20		
产品性能	测试结果	测试标准
颜色	白色	目视
添加料	金属氧化物	***
粘度 25°C	200Pa. s	Brookfield RVF, #7
密度 g/cm ³	2.20	ASTM D792
使用温度 °C	-45 - 150°C	***
导热率 W/m. k	2.0	ASTM D5470
热失重 (125°C/48H)	<0.2%	***
热阻抗 (°C*in ² /W)@30psi	0.034	ASTM D5470
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具, 记录值包括界面热阻. 这些数值仅供参考. 实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力.

【特点与优势/Features And Benefits】

- 耐干枯
- 无硅氧烷小分子挥发
- 无需预热
- 适用于自动配料及丝网印刷等生产工艺

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处, 不要接触明火. 本产品无毒, 按非危险品贮存及运输.

【包装】 1.0KG/罐装.

【有效期】 本产品有效期为 12 个月.

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》.